

证券代码：300480

证券简称：光力科技



# 光力科技股份有限公司

(河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号)

## 2020年向特定对象发行A股股票预案

二〇二〇年九月

## 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。

3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。中国证监会等监管部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

## 特别提示

1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次发行的最终发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）及其他机构投资者、自然人投资者等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

4、本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 249,343,810 股的 30%，即 74,803,143 股（含本数），最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。

5、本次发行完成后，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等相关部门的规定执行。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票限售期的规定有最新的规定或监管意见，公司将按其进行相应调整。

6、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	半导体智能制造产业基地项目（一期）	40,228.98	40,000.00
2	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		<b>55,228.98</b>	<b>55,000.00</b>

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

7、在本次向特定对象发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

8、本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

9、本次发行完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

10、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司第四届董事会第六次会议制定《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，除满足《公司章程》中有关利润分配政策的条款的规定外，进一步完善了公司利润分配政策。

关于公司利润分配政策和现金分红的详细情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

11、本次向特定对象发行完成后，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股收益等财务指标）存在短期内下降的可能，提请投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄股东即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司制定了本次向特定对象发行 A 股股票后摊薄即期回报的填补措施，同时公司的实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第六节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施”。

虽然公司为应对即期回报被摊薄制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

12、本次向特定对象发行 A 股股票方案最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定，尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

## 目 录

公司声明	1
目 录	5
释 义	7
一、一般释义	7
二、专业释义	7
<b>第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要</b>	<b>9</b>
一、公司基本情况	9
二、本次向特定对象发行的背景和目的	9
三、本次向特定对象发行方案概况	13
四、本次发行是否构成关联交易	16
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	16
<b>第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析</b>	<b>18</b>
一、本次募集资金投资计划	18
二、募集资金投资项目的具体情况	18
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	28
四、可行性分析结论	28
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</b>	<b>29</b>
一、本次发行后公司业务收入结构、股东结构、公司章程、高管人员结构变化情况	29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	29
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	30
四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	30
五、本次发行对公司负债情况的影响	30
<b>第四节 本次发行相关风险的说明</b>	<b>31</b>

一、宏观经济环境风险.....	31
二、核心人员流失风险.....	31
三、技术开发风险.....	31
四、应收账款回收风险.....	32
五、募集资金投资项目实施风险.....	32
六、每股收益和净资产收益率被摊薄的风险.....	32
七、股票价格波动风险.....	32
八、发行风险.....	33
<b>第五节 公司利润分配政策及执行情况.....</b>	<b>34</b>
一、公司利润分配政策的制定.....	34
二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况.....	36
三、公司股东回报规划.....	37
<b>第六节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施.....</b>	<b>42</b>
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.....	42
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示.....	45
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性.....	45
四、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施.....	45
五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺.....	47
六、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序.....	48

## 释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

### 一、一般释义

光力科技、发行人、公司	指	光力科技股份有限公司
LP、LP 公司	指	Loadpoint Limited，公司控股子公司，注册地在英国
LPB、LPB 公司	指	Loadpoint Bearings Limited，公司全资子公司，注册地在英国
先进微电子	指	先进微电子装备（郑州）有限公司
ADT、ADT 公司	指	Advanced Dicing Technologies Ltd，先进微电子下属公司，注册地在以色列
本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行	指	光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票
预案、本预案	指	光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案
定价基准日	指	光力科技本次向特定对象发行 A 股股票的发行期首日
股东大会	指	光力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	光力科技股份有限公司董事会
A 股	指	在深交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司普通股
公司章程	指	光力科技股份有限公司章程
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、专业释义

封测、半导体封测	指	半导体封装测试，指对通过中间测试的晶圆按照产品型号及功能需求，进行多种封装工艺加工和最终测试得到独立芯片的过程
IC 设计	指	集成电路设计
热电性	指	指电介质的极化强度随温度变化而改变，从而在其表面发生电荷的释放和吸收的性质



本预案中部分合计数与各明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。

## 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要

### 一、公司基本情况

公司名称	光力科技股份有限公司
英文名称	GL Tech Co., LTD
成立时间	1994-01-22
股票上市地	深圳证券交易所
股本	249,343,810 股
A 股股票简称	光力科技
A 股股票代码	300480
法定代表人	赵彤宇
注册地址	郑州高新开发区长椿路 10 号
办公地址	郑州高新开发区长椿路 10 号
邮政编码	450001
电话	0371-67858887
传真	0371-67991111
网址	www.gltech.cn
经营范围	传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、本次向特定对象发行的背景和目的

#### （一）本次向特定对象发行的背景

##### 1、国家大力推动拥有自主知识产权的半导体设备及其核心技术的发展

芯片是信息化时代最核心的要素之一，中国在半导体产业中特别是核心芯片自给率极低，对于国家和企业而言尤为不利，无论从国家安全还是电子信息产业的发展而言，全力推动半导体产业链发展目前已经成为了全国上下的一致共识。

近年来，国家接连出台一系列相关政策支持 and 引导半导体产业的发展，促进半导体产业的生态环境建设和产业链优化，鼓励 IC 设计、芯片制造、封装测试和设备厂商的协同发展。在国家科技重大专项以及各地方政府、科技创新专项的大力支持下，国产半导体设备销售快速稳步增长，多种产品实现从无到有的突破，不少核心工艺设备已经通过用户端考核进入批量生产阶段，在国内集成电路大生产线上运行使用。

## 2、半导体及半导体封装设备领域市场前景广阔

近年来，中国半导体产业高速发展，根据中国半导体行业协会统计，2019 年中国半导体产业实现销售额 7,562 亿元，较 2018 年同比增长 15.80%，远高于全球半导体行业的整体增速，预计未来几年中国半导体行业增速仍将保持较高的增速。

由于市场对于微型化、更强功能、更低功耗及热电性能改善的产品需求不断提升，半导体封测技术的精密度、复杂度和定制性继续增强，并导致众多半导体制造商将封测业务外包给专门的封测外包企业，不仅有利于提升产品品质，同时还可以降低此资本密集度较高行业的资本支出。中国半导体封装业在整个半导体产业中发展较早，规模和技术已看齐世界大厂。根据中国半导体行业协会数据，我国半导体封测行业一直保持高速发展，2019 年中国半导体封测市场规模 2,350 亿元，较 2018 年同比增长 7.1%。未来，随着 5G 通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端、物联网的需求和技术不断发展，市场需求不断扩大，为国内封装企业提供了良好的发展机会，带动半导体产业的发展，推动先进封装的需求扩张，成为封装领域新的增长动能。

同时，半导体设备是半导体产业发展的基础，中国的半导体封测产业规模和技术发展较快，但使用的设备仍然主要依赖进口，国产化问题尚未解决，目前国产半导体专用设备因技术和应用工艺开发等尚不完备，高端设备产品仍然依赖进口。在中国半导体设备市场，国内企业市场份额极低，且市场占有率提升缓慢，设备的国产化和核心技术的自主化是涉及国家经济发达的问题之一。

## 3、公司拥有半导体封装领域先进精密切割技术和核心零部件

公司下属 LP 公司的主营业务为研发、生产销售用于半导体等微电子器件精

密加工的设备，主要产品对半导体晶圆、芯片封装基板及微电子元器件基体进行高精度、高可靠性切割系列设备，是半导体器件（如集成电路芯片、电子元器件、MEMS 和各类传感器等）制造过程中的关键设备之一，可用于半导体芯片制造、航空航天和军工等领域，属于光机电一体化的高端装备制造业。1968 年，LP 公司在全球第一个发明了加工半导体器件的划片/切割机，目前产品主要销往欧洲和北美的芯片制造业、传感器制造业、高新材料制造业、航空航天、军工领域、大学和科研机构等，并在亚洲市场有少量销售。在加工超薄和超厚半导体器件领域，LP 公司产品拥有领先优势。

公司下属 LPB 公司在开发、生产高性能高精空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器的领域一直处于业界领先地位。1971 年，LPB 公司的气浮主轴被安装在划片机上，是世界上第一个在半导体划片机上使用气浮主轴的公司。LPB 公司产品广泛应用在半导体工业芯片封测工序——精密高效切割划片设备、隐形眼镜行业的精加工设备等领域，具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势。LPB 公司长期与英国的大学、研究机构和大中型的跨国公司合作，已把核心产品的制造经验细化成一系列易理解的计算机程序模块，并在空气轴承系统中的直流无刷电机方面做出了创新，开发出基于空气承载的主轴定位精度达到了纳米级，通常在 10 纳米以下，在满足客户对高性能空气主轴和新概念主轴需求方面在业界居于领先地位。LPB 公司不仅能提供关系到切割划片设备性能的最核心部件，同时也为国际上其他公司提供对半导体晶圆等硬脆材料进行研磨、抛光等设备所需的高性能空气主轴。

公司参股投资收购的以色列 ADT 公司前身为美国 K&S 公司（库力索法半导体有限公司）以色列切割设备及刀片制造销售部门，2003 年被投资者收购并成立 ADT 公司，在半导体、微电子后道封测装备领域已有几十年的经验，在半导体切割划片精度方面处于行业领先水平，其自主研发的切割划片设备最关键的精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1 微米的控制精度。ADT 公司的生产软刀在业界处于领先地位，客户认知度较高。ADT 公司具备按照客户需求提供定制的刀片和微调特性的工程资源，能够为客户提供量身定制的整体切割划片解决方案。ADT 产品的部分性能在全球处于领先地位，公司是行业内仅有的两家既有切割划片机设备，又有核心零部件——高精空气浮主轴的公司，综合竞争优势

突出。

综上所述，通过并购，公司拥有了半导体封装设备领域精密切割划片技术和核心零部件的研发、生产、客户定制化制造和技术服务能力，可利用中国巨大的市场需求和本土化制造优势，提升产品核心竞争力，快速开展相关业务。

## （二）本次向特定对象发行的目的

### 1、拓展半导体封装设备业务，提升公司在半导体领域的核心竞争力

为加速国际化整体战略的实施，掌握半导体精密制造设备核心技术，同时把握半导体高端装备制造中国及亚洲可观的商业机会，公司自上市后大力开拓国际业务板块，拥有了包括高性能高精度空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器产品生产和技术研发的实力，为公司开拓半导体产业高端装备制造业务奠定了坚实的基础，使公司在此领域快速拥有了技术、品牌、客户、市场等多方面的竞争力。公司进一步拓展半导体封装设备业务可以加快公司半导体装备制造业务国产化的进度，可为公司在半导体高端装备制造领域的主营业务获取更多和更稳定的营业利润提供保障。

### 2、发展高端封测设备核心技术，满足半导体高端封测工艺需要

随着全球电子信息产业的转移、我国在电子类产品的消费升级，促使我国半导体产业的升级加速，但半导体产业的升级也对配套装备制造提出了更高的要求，要求配套装备制造商提升技术水平、扩大生产规模，满足市场需求，进而促进半导体产业升级。

目前国产设备加工精度不高，不能满足先进封装技术的加工需求。公司经过多年经营，通过并购英国 LP 公司、LPB 公司，同时通过参股先进微电子，先进微电子以其全资子公司上海精切半导体设备有限公司收购以色列 ADT 公司 100%股权，公司已经拥有了国际知名品牌、全球客户资源和供应链、行业领先的技术优势、及经验丰富的优秀管理人才，目前亟需扩大生产规模。顺势而为推进半导体高端装备智能制造产业基地项目既是公司谋求长远发展的必然选择，也是市场的必然要求。

半导体封测设备主要应用于 IC 和各种半导体传感器、MEMS 等电子元器件的封装测试环节。随着 5G、人工智能、大数据等应用的不断扩张，对半导体器件性能的要求不断提高，而先进封装技术在提升芯片性能方面展现的巨大优势，吸引了全球各大主流 IC 封测厂商在先进封装领域进行持续布局。随着先进封装方式的发展，要求封装厂商和封装设备持续提供更加微型化、更强功能、更高复杂度以及定制性的服务。原有的封装设备逐步被淘汰，封装厂需要购买新的封装设备，以适应不断演进的工艺技术需求。先进封装技术中对于晶圆的尺寸、质量、良率、效率有多重要求，这就要求切割划片过程非常稳定、高效，同时能够满足足够小的加工尺寸。本次发行募集资金投资项目所生产的切割划片设备及系统应用于封装的前段工艺中的晶圆切割，达产后所生产的切割划片设备及系统可满足先进封装技术对晶圆切割的要求。

### 3、优化资本结构，补充流动资金

公司业务属于资金密集型和技术密集型行业，公司日常经营活动必须具备充足的营运资金保障。而要实现上述产业规划，公司将需要更多的流动资金投入到研发、采购、生产、营销、服务等业务环节。公司若仅通过自身积累将很难满足业务快速扩张的需求，公司未来存在较大的营运资金缺口。为此，公司将充分利用上市公司融资平台的优势，扩大直接融资规模，本次募集资金用于补充流动资金，可以在一定程度上解决公司业务扩张过程中的资金需求，有利于公司战略规划的成功实施。

## 三、本次向特定对象发行方案概况

### （一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行方式及发行时间

本次发行股票采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。

### （三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

### （四）定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。

最终发行价格将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整，调整方式如下：

1、分红派息： $P1=P0-D$

2、资本公积转增股本或送股： $P1=P0/(1+N)$

### 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股分红派息金额，N 为每股资本公积转增股本或送股数，P1 为调整后发行价格。

#### （五）发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 74,803,143 股（含本数），最终发行股票数量上限以深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。

#### （六）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份锁定期限内，认购对象就其所认购的本次发行的股份，由于本公司送红股、转增股本的原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。

限售期满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

#### （七）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	半导体智能制造产业基地项目（一期）	40,228.98	40,000.00
2	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		55,228.98	55,000.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。



若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

#### **（八）上市公司滚存未分配利润的安排**

在本次向特定对象发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

#### **（九）上市地点**

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

#### **（十）决议有效期**

本次向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

### **四、本次发行是否构成关联交易**

本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过 35 名投资者。

本次向特定对象发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。

截至本预案公告日，本次向特定对象发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因其他关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告中披露。

### **五、本次发行是否导致公司控制权发生变化**

截至本预案出具日，赵彤宇先生直接持有公司股份 96,269,603 股，通过宁波万丰隆贸易有限公司控制公司股份 11,384,907 股，合计占公司总股本 249,343,810 股的 43.18%，为公司的控股股东及实际控制人。

假设按照本次向特定对象发行的股票数量上限 74,803,143 股进行测算, 本次发行完成后, 赵彤宇先生持有公司股份比例为 33.21%, 仍为公司的实际控制人。

本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

## 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

本次向特定对象发行相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

本次向特定对象发行 A 股股票尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。在获得中国证监会同意注册的文件后, 公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜, 履行本次向特定对象发行 A 股股票相关程序。

## 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

### 一、本次募集资金投资计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	半导体智能制造产业基地项目（一期）	40,228.98	40,000.00
2	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		<b>55,228.98</b>	<b>55,000.00</b>

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

### 二、募集资金投资项目的具体情况

#### （一）半导体智能制造产业基地项目（一期）

##### 1、项目概况

本项目拟建设 3 栋生产厂房、2 栋生产配套用房、1 栋研发楼、1 栋生活楼用于建设半导体划片机生产线，进行集成电路封装过程中的精密划片设备及系统的生产、调试、检测，同时引进设备、招募人员进行生产管理。

预计项目建成后，形成年产 300 套半导体精密划片设备及系统的产能。

##### 2、项目实施的必要性

（1）发展拥有自主知识产权的半导体设备核心技术是国家政策的贯彻体现

中国半导体产业中特别是核心芯片自给率极低，对于国家和企业而言尤为不利，无论从国家安全还是电子信息产业的发展而言，全力推动半导体产业链发展目前已经成为了全国上下的一致共识。

半导体高端加工装备是半导体产业发展的基础，设备的自主化是涉及国家经济发展的核心问题之一，政府从政策层面，予以税收、产业发展、金融等多项优惠政策。近年来，国家出台了多项优惠政策支持中国半导体设备发展，并在《中国制造 2025》对于半导体设备国产化提出了明确要求：在 2020 年之前，90~32nm 工艺设备国产化率达到 50%，实现 90nm 光刻机国产化，封测关键设备国产化率达到 50%。在 2025 年之前，20~14nm 工艺设备国产化率达到 30%，实现浸没式光刻机国产化。到 2030 年，实现 18 英寸工艺设备、EUV 光刻机、封测设备的国产化。

在上述情形下，公司大力发展拥有自主知识产权的半导体设备核心技术是顺应市场需要和政策要求的体现。

## （2）发展高端封测设备核心技术是满足半导体高端封测工艺的需要

随着先进封装技术和封装方式的发展，要求封装厂商和封装设备持续提供在工艺加工能力上提供更加微细化、更强功能、更高复杂度以及可定制化的服务。原有的封装设备逐步被淘汰，封装厂需要购买新的封装设备，以适应不断演进的技术需求。

晶圆切割划片是半导体芯片制造工艺流程中的一道必不可少的工序，在晶圆制造中属后道封装工序，随着晶圆直径越来越大，单位面积上集成的 IC 越来越多，留给分割的划切道也越来越小。同时，随着晶圆减薄工艺技术的发展以及叠层封装技术的成熟，芯片的厚度越来越薄，对晶圆切割划片设备性能的要求也越来越高，作为 IC 后封装生产过程中关键设备之一的晶圆切割划片机，也由 150mm、200mm 发展到 300mm。

公司经过多年的经营发展，通过并购英国 LP 公司、LPB 公司，同时通过参股先进微电子，先进微电子以其全资子公司上海精切半导体设备有限公司收购以色列 ADT 公司 100% 股权，已经拥有了国际知名品牌、全球客户资源和供应链、行业领先的技术优势、及经验丰富的优秀管理人才团队，目前亟需扩大生产规模。

顺势而为推进半导体高端装备智能制造产业基地项目既是公司谋求长远发展的必然选择，也是市场的必然要求。

### （3）拓展半导体高端封装设备业务是满足国内先进封装市场的需要

中国半导体产业赶上世界先进水平仍需时日，但封装技术门槛相对较低，国内发展基础相对较好，中国半导体封测行业的发展速度相比半导体的 IC 设计和制造业更快。目前大陆半导体封测厂商与业内领先厂商的技术差距正在缩小，已基本已逐渐掌握最先进的封装技术。从长远看，随着国内上游芯片设计公司的崛起，下游配套晶圆代工厂建厂逻辑和规划的兑现，辅以国家政策和产业资本的支持，国内封测企业有望继续保持快速增长。

在国内先进封装市场快速增长的背景下，相对应的是高端封装设备被国外公司所垄断。在高端精密切割划片设备领域，日本 DISCO、东京精密 TSK、以色列 ADT 三家公司占据了该领域较大的市场份额，国产半导体设备与国外产品相比在技术水平上仍有巨大差距，品牌知名度也尚缺，缺乏市场竞争能力，在全球市场中所占的份额很小，相关半导体设备的国产替代空间很大。公司通过并购英国 LP 公司、LPB 公司、参股 ADT 公司拥有了行业领先的技术优势及经验丰富的优秀管理人才，拥有了国际知名品牌、全球客户资源和供应链，在高端精密切割划片设备领域拥有世界一流的技术水平，通过发展满足先进封装技术的高端封装设备替代进口设备，是满足国内先进封装市场的需要。

### （4）拓展半导体封装设备业务是公司提升核心竞争力的需要

为加速国际化整体战略的实施，掌握半导体精密制造设备核心技术，同时把握半导体高端装备制造中国及亚洲可观的商业机会，公司自上市后开拓国际业务板块，拥有了包括高性能高精空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器产品生产和技术研发的实力，为企业开拓了半导体产业和高端装备制造业务领域，并在此领域拥有了技术、品牌、客户、市场等多方面的竞争力，拓展半导体封装设备业务可以为公司在半导体领域提升核心竞争力，从而在半导体领域的主营业务获取更多和更稳定的营业利润提供保障。

LP 公司和 ADT 公司的产品主要应用于半导体等微电子器件的制造领域，我国在该领域的产品以进口设备为主，目前 LP 公司和 ADT 公司产品主要销往欧

洲和北美，但该领域产品的最大市场在中国和其它亚洲市场，公司将把握中国及亚洲的商业机会积极拓展市场；LPB 公司的主要产品主要供应 LP 公司和 ADT 公司，属于核心零部件，三家公司的业务协同性可以进一步提升更高的切割划片设备的产品质量，同时降低生产成本；同时，LP 公司、LPB 公司、ADT 公司的产品属于光机电一体化装备，和公司原有生产安全监控系统的各类产品可以共享一个技术平台，降低产品的制造成本、提高产品的竞争力，从而提升公司获利能力和股东价值。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 国家产业政策大力支持半导体产业发展

近年来，国家接连出台一系列相关政策支持 and 引导半导体产业的发展，促进半导体产业的生态环境建设和产业链优化，鼓励 IC 设计、封装和设备厂商协同发展，相关政策如下：

时间	政策	部门	主要内容
2000 年 6 月	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	国务院	集成电路的核心政策，在投融资政策、税收政策、产业技术政策、出口政策、收入分配政策等方面对集成电路产业实施优惠。
2002 年 1 月	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策》	财政部、国税总局	把税收优惠范围扩大到集成电路产业上游的涉及企业和下游制造商。
2009 年 4 月	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院	我国电子信息产业要围绕九大重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性借新产业实现突破、通过新应用带动新增长的任务。
2010 年 1 月	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
2011 年 2 月	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	国务院	加大对重大科技专项资金支持，鼓励和引导社会资金、金融企业向该领域投入，支持企业进行知识产权专利申请，支持企业引入海外人才。明确提出将继续实施软件增值税受优惠政策。
2011 年 11 月	《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额》	财政部、国税总局	解决集成电路重大项目企业采购设备引起的增值税进项税额占用资金问题，决定对其因购进设备形成的增值税期末留抵税额予以退还。

时间	政策	部门	主要内容
2012 年 2 月	《集成电路产业“十二五”发展规划》	工信部	到“十二五”末，产业规模再翻一番以上，培训骨干设计企业，骨干芯片制造企业、骨干封测企业，形成一批创新活力强的中小企业。
2012 年 7 月	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破现金和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，培育集成电路产业竞争新优势。
2014 年 6 月	《国产集成电路产业发展推进纲要》	工信部	以设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，推动集成电路产业重点突破和整体提升，实现跨越发展。
2015 年 3 月	《鼓励集成电路产业发展企业所得税政策》	财政部	符合条件的企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
2015 年 5 月	《中国制造 2025》	国务院	将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，提升集成电路设计、制作、封装和测试的自主发展能力。
2016 年 11 月	《我国集成电路产业“十三五”发展规划建议》	国务院	到 2020 年全行业销售收入达到 9300 亿元；16/14nm 制造工艺实现规模量产，封装测试技术进入全球第一梯队，关键装备和材料进入国际采购体系。
2017 年 4 月	《科技部关于<印发“十三五”材料领域科技创新专项计划>的通知》	科技部	第三代半导体材料与半导体照明整体达到国际先进水平，部分关键技术达到国际领先水平。
2018 年 3 月	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》	财政部、税务总局、发改委、工信部	2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成的电路线宽小于 65nm 或投资额超过 150 亿元，且经营期 15 年以上的集成电路生产企业或项目，前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。
2020 年 8 月 4 日	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件由工业和信息化部会同相关部门制定。

半导体设备市场正处于下游市场强劲增长和生产工艺更新的双重利好时期，处于行业景气上升阶段。在全球半导体周期性影响和全球半导体产业转移以及以美国为首的部分西方国家对中国实施前所未有的技术封锁的背景下，中国不断出台相关政策，以空前的力度支持中国半导体产业并带动巨额资金支持中国半导体

产业发展，国内晶圆代工产线和 IDM（整合元件制造商，Integrated Device Manufacturing）产线迎来建设高峰，带来巨大设备需求空间，行业景气向好带动中国半导体设备需求到高增长区间。本项目国产化实施恰逢这一重要的历史时刻，具有重大的意义。

## （2）半导体及半导体封装设备领域市场前景广阔

募集资金投资项目建成后，相关产品应用于半导体封装领域，归属于半导体产业。半导体产业、半导体封装行业、半导体设备行业、半导体封装设备行业均具有广阔的市场前景。

近年中国半导体产业高速发展，根据中国半导体行业协会统计，2019 年中国半导体产业实现销售额 7,562 亿元，较 2018 年同比增长 15.80%，远高于全球行业整体增速，预计未来几年行业增速仍将保持较高增速。

由于电子信息市场对于半导体产品的微型化、更强功能性及热电性能改善的需求提升，半导体封测技术的精密度、复杂度和定制性继续增强，并导致众多半导体制造商将封测业务外包给专门的封测外包企业，不仅有利于提升产品品质，同时还可以降低此资本密集度较高行业的资本支出。中国半导体封装业在整个半导体产业中发展较早，规模和技术已经不落后于世界大厂。根据中国半导体行业协会数据，我国半导体封测行业一直保持高速发展，2019 年中国半导体封测市场规模 2,350 亿元，较 2018 年同比增长 7.1%。未来，随着 5G 通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端、物联网的需求和技术不断发展，市场需求不断扩大，为国内封装企业提供良好的发展机会，带动半导体产业的发展，推动先进封装的需求，成为封装领域新的增长动能。

（3）公司重点布局半导体封装设备领域，在半导体后道封测高端装备领域具有较为明显的领先优势

公司先后收购英国 LP 公司、LPB 公司，参股收购以色列 ADT 公司，借助收购海外优质资产，引进先进核心技术，重点布局半导体封测装备业务。LP 公司主要产品用于半导体等微电子器件的划片、切割系列设备，该设备是半导体器件制造的关键设备之一；LPB 公司主要产品包括高性能高精度空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器等，其主要应用于半导体工业芯片



封装的精密高效切割工序，此外在隐形眼镜行业的精加工领域也有广泛应用；ADT 公司产品包括切割划片机、划片刀和外围设备，其晶圆切割划片机市场占有率位列世界前列，自主研发的切割划片设备最关键的精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1 微米的控制精度，达到业内领先水平。ADT 公司的软刀技术水平处于世界领先地位，客户认知度较高。公司收购的海外优质资产，在半导体封装设备领域具有全球较为领先技术实力，奠定了公司在半导体后道封测高端装备领域的领先优势。

综上，公司通过并购拥有半导体封装设备领域精密切割技术和核心零部件的研发、生产、客户定制化制造和技术服务能力，可利用中国及亚洲巨大的市场需求和本土化制造优势，提升产品核心竞争力，快速开展相关业务。

(4) 公司原有业务板块拥有较强的协同效应以保障项目经济指标的达成

经过多年发展，公司已经在原有业务板块积累了丰富的软、硬件技术经验以及产品可靠性制造经验，培养出了大批优秀的管理人才、软硬件及结构设计等研发人才、精密加工制造人才。公司是河南省首家通过 CMMI5 级软件认证的企业，核心管理团队经过多年锤炼，相互配合密切，具有敏锐的战略眼光和洞察力，管理团队充分认同企业的核心文化和发展战略。

公司于 SEMICON China 2020 国际半导体展会展出了本土化研制的双轴 12 寸全自动划片机，除了继承了 LP 公司、LPB 公司和 ADT 公司几十年积累下来的经验和技術外，研发团队也将公司长期积累的软件技术精华和在复杂电磁干扰、高湿、高粉尘等恶劣环境下长期可靠工作的微电子技术植入到产品中，为产品的快速研发成功和成本控制做出了贡献，目前该产品已经成熟并成功面世。

同时，公司作为上市公司经过多年的经营，在生产、管理、品牌方面积累了丰富经验，可有力保障本项目的产品能够顺利实现量产，并通过现有 ADT 公司、LP 公司、LPB 公司的客户资源和销售网络，完成销售目标，保障完成本募集资金投资项目的业务目标和经济指标。

#### 4、项目建设规划

(1) 项目实施主体

项目的实施主体为郑州光力瑞弘电子科技有限公司，为公司全资子公司。

## （2）项目投资额

项目总投资金额为 40,228.98 万元，拟使用募集资金投入 40,000.00 万元。

## （3）项目建设内容

项目拟在自有土地上建设 3 栋生产厂房、2 栋生产配套用房、1 栋研发楼、1 栋生活楼用于建设半导体划片机生产线，进行集成电路封装过程中的精密划片设备及系统的生产、调试、检测，同时引进设备、招募人员进行生产管理，其中建筑工程包括生产厂房、生产配套用房、研发楼、生活楼、仓库堆场、附属设施等工程新建，设备引进主要包括生产设备、运输设备及办公设备等。项目所使用的土地面积 80 亩，预计项目建成后将形成年产 300 套半导体精密划片设备及系统的产能。

## （4）项目建设周期

本项目建设周期为 2 年。

## （5）项目预期效益

经测算，项目全投资内部收益率为 18.19%（税后），投资税后回收期 4.91 年（含建设期），项目的经济效益较好。

## （6）项目的批复或备案文件

项目已取得郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）经济发展局（安全生产监督管理局）投资项目备案（项目代码：2018-410151-35-03-069165），并取得郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局环境影响报告表的批复（备案文号：郑港环表（2019）35 号）。

## （二）补充流动资金项目

### 1、项目概况

公司拟将本次募集资金中的 15,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，增强公司资金实力，提高抗

风险能力。

## 2、项目实施的必要性和可行性

(1) 公司双主业并驾齐驱，定位高端装备，市场发展机遇前景广阔

公司的核心管理团队经过多年锤炼，相互配合密切，具有敏锐的战略眼光和洞察力，管理团队充分认同企业的核心文化和发展战略。2015 年 7 月公司上市以来，一方面持续做强做大原有第一安全生产监控装备业务板块，一方面马不停蹄通过境外并购布局第二半导体封测装备业务板块，完成了双主业并驾齐驱的战略布局，从而将公司由一家中国高新技术企业转变为一家以中国为根基的国际化高新技术企业。目前，公司双主营业务板块正面临较大市场发展机遇。

安全生产监控装备业务方面，经过多年发展，公司已经积累了丰富的软、硬件技术经验、产品可靠性制造经验，培养出了大批优秀的管理人才、软硬件及结构设计等研发人才、精密加工制造人才。在该领域，公司具有核心竞争优势，盈利能力出色。近年来，我国煤炭供给侧结构性改革成效显著，煤炭行业已经开始进入了一个稳定发展期，同时，随着煤炭行业兼并重组加速，行业集中度上升，大型煤矿集团控制的矿山数量大幅增加，而大型煤矿集团更加注重安全生产与长期利益，注重智能化矿山建设，为在该领域拥有核心竞争优势的公司提供了更好地发展空间。

在半导体封测装备业务方面，半导体器件等微电子制造业是我国大力发展的产业，进口设备在半导体器件制造领域占据垄断地位，近年来，我国每年进口半导体芯片总额超过 2000 亿美元，半导体器件等微电子制造业已成为国家大力发展的产业。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造 2025》等文件，未来中国对半导体制造行业的投资将达 1500 亿美元，到 2025 年前使中国制造的集成电路在国内市场份额从 9%扩大至 70%。报告期内，公司收购两个英国半导体公司 LP 和 LPB，参股以色列 ADT 公司，使得公司在半导体后道封测装备领域具有更强的竞争能力。公司正在进一步整合和优化国内外产业链，全力以赴推进半导体后道封测装备国产化的进程。

(2) 募集资金用于补充流动资金是公司强化主业发展，抓住行业机遇的需要

公司坚持走以中国为根基的国际化发展道路，沿着既定的双主业战略发展方向——安全生产监控装备和半导体封测装备两大业务板块，在生产经营、研发创新、市场开拓、并购整合等方面做了大量的工作，进一步提高公司核心竞争力。

上述产业规划的稳步开展将使公司的业务实现跨越式发展。但由于相关产业属于资金密集型和技术密集型行业，公司日常经营活动必须具备充足的营运资金保障。而要实现上述产业规划，公司将需要更多的流动资金投入到研发、采购、生产、人员、营销等业务环节。公司若仅通过自身积累将很难满足业务快速扩张的需求，公司未来存在较大的营运资金缺口。为此，公司将充分利用上市公司融资平台的优势，扩大直接融资规模，本次募集资金用于补充流动资金，可以在一定程度上解决公司业务扩张过程中的资金需求，有利于公司战略规划的成功实施。

(3) 坚持自主研发的科技战略，建立以充分满足市场个性化需求为目标的科技成果转化体系

自成立以来，公司始终坚持自主研发的科技战略，紧跟市场需求与国际技术发展趋势，建立了专业的研发机构，打造了一支集应用研究与生产实践紧密结合，横跨微电子、光电传感测量、机械精密加工、工业自动化、软件工程等多专业的，具备持续创新能力的研发队伍。截止 2020 年 6 月末，公司累计获授权专利 300 余项，其中发明专利 70 余项，三项专利分别获得第十四届、第十五届、第十七届中国专利奖优秀奖。公司还先后承担了科技部、国家发改委和工信部等九项目，多项产品被列入国家重点新产品、国家火炬计划以及国家重点推广技术。

本次向特定对象发行筹措资金将有助于补充公司业务发展所需的流动资金，公司一方面全面推动 ADT 公司、LP 公司、LPB 公司在业务、研发、生产、供应链、产品等方面整合和深度合作，重建销售和服务团队，加大市场开拓力度，全面提升公司在该领域的整体竞争力，全力以赴的推进半导体后道封测装备国产化的进程，充分发挥中国本土化生产的成本优势；另一方面，公司将继续加大研发投入，充分发挥国内外研发团队各自优势和强化协同效应，加快研发创新的步伐，加快新产品在客户处的验证工作；此外，公司将加大相关设施配置，扩大产业规模，为加速拓展中国及亚洲市场提供更有力的支持。

### 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

#### （一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行募集资金将用于半导体智能制造产业基地项目（一期）及补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次向特定对象发行及募集资金投资项目实施将加快半导体封测划片机高端装备本土化进程，进一步优化公司产品结构，降低生产成本，提高盈利能力，有助于进一步提升公司的综合竞争力以及巩固公司在行业中的地位。

#### （二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资金实力将得到有效提升；另一方面，由于本次发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法体现，因此公司的每股收益等在短期内存在被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

### 四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略，产品符合市场需求，上述项目的实施助推半导体高端装备国产化替代，有利于公司经济效益的提高，并将进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，从而提高股东回报。因此，本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目是切实可行的。

### 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

#### 一、本次发行后公司业务收入结构、股东结构、公司章程、高管人员结构变化情况

##### （一）本次发行完成后公司业务、收入结构变化情况

本次向特定对象发行的募集资金将用于半导体智能制造产业基地项目（一期）及补充流动资金，与公司目前主营业务结构及未来业务发展战略相适应。本次发行完成后，将有利于提高公司的资金实力，促进公司业务的发展，增强公司综合竞争实力，扩大公司收入规模，提升公司盈利能力，公司业务、收入结构不会发生重大变化。

##### （二）本次发行完成后公司股东结构变化情况

本次向特定对象发行股票完成前后，公司控股股东和实际控制人的地位不会发生变化。

##### （三）本次发行完成后公司章程变化情况

本次向特定对象发行完成后，公司股本将相应增加。公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

##### （四）本次发行完成后高管人员结构变化情况

截至本预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行重大调整的计划。本次发行后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。

#### 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行后，公司的总资产、净资产将相应增加，资产负债率将有所下降，公司的财务结构得到改善，偿债能力进一步增强。募集资金投资项目顺利实施后，公司的盈利能力将得到提升，经营活动的现金流量将进一步增加。

### 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面继续保持独立，并各自承担经营责任和风险。本次发行不会导致公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间产生同业竞争或新增关联交易。

### 四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本预案出具日，公司的资金使用或对外担保严格按照法律法规和公司章程的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被主要股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不存在资金被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

### 五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并口径的资产负债率为 14.28%。由于近年来市场竞争较为激烈，以及疫情带来的国内及国际经济发展的不确定性加大，公司经营风险相应加大，本次发行募集资金到位后，公司资产总额和净资产相应增加，将降低公司的负债率优化公司资产结构，增强公司抗风险能力。

本次发行完成后，公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

## 第四节 本次发行相关风险的说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

### 一、宏观经济环境风险

公司所处行业受宏观经济及市场供需状况的影响，会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。未来全球经济和贸易形势仍存在一定不确定性，全球宏观经济整体面临下滑风险，全球范围内的资源流动及配置受到一定限制，全球金融市场亦出现波动和调整趋势。如果国内外经济形势和产业政策发生重大变动，将使得未来一定时期内公司的市场环境、经营业绩、研发项目进度等方面存在不确定性风险。

### 二、核心人员流失风险

公司所处行业为技术密集型行业，技术的先进性对公司的发展十分重要，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，主要高管及关键技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护及一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，与相关人员签订了《保密协议》等，而且截至目前，公司未发生过技术泄密的情况，但仍存在由于管理不善或竞争挖角导致关键人才流失、核心技术泄密的风险，对公司持续经营和盈利能力产生不利影响。

### 三、技术开发风险

作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。随着公司业务规模扩大，发行人将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售策略滞后，将对发行人未来发展带来不利影响。



#### 四、应收账款回收风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款净额 15,708.04 万元，应收账款余额相对较大，对公司资金的流动性产生不利影响。公司通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，实现全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，加大绩效考核力度，加速应收账款的回款。针对一些账龄偏长的欠款，成立专门清欠组，进行专项管理。但未来若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大公司应收账款发生坏账的风险。

#### 五、募集资金投资项目实施风险

公司本次向特定对象发行募集资金拟用于半导体智能制造产业基地项目（一期）及补充流动资金，上述项目是基于当前市场环境、行业及技术发展趋势、公司战略需求等因素，经过慎重、充分的可行性分析论证做出的，有利于进一步深化公司业务布局、优化公司业务体系、完善公司运营管理机制、提高公司盈利能力和综合竞争力，巩固行业地位。但是，募投项目的实施是一个系统工程，需要一定时间，若在实施过程中，宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替，或因募集资金不能及时到位等其他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期实施，将可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。

#### 六、每股收益和净资产收益率被摊薄的风险

本次向特定对象发行完成后，公司净资产规模和股本总额相应增加。由于募投项目建设和产生效益需要一定周期，如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长，则短期内公司每股收益和净资产收益率将存在下降的风险。

#### 七、股票价格波动风险

本次向特定对象发行 A 股股票将对公司的财务状况和生产经营发生重大影响，并进而影响公司股票价格。然而，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家宏观经济形势、重大产业政策、全球经济形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存

在，公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。

## 八、发行风险

由于本次发行只能向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，公司本次向特定对象发行存在发行募集资金不足的风险。

## 第五节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、公司利润分配政策的制定

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定的相关要求，公司制定了相应的《公司章程》，根据最新《公司章程》，公司利润分配政策如下：

“第一百五十五条 公司的利润分配制度如下

（一）利润分配政策的决策程序：

公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项的决策程序和表决机制如下：

#### 1、董事会的研究论证程序和决策机制

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

#### 2、监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

#### 3、股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。

## （二）利润分配形式：

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，其中现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。公司经综合考虑具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，有重大投资计划或重大现金支出等事项发生除外。

公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。经过详细论证后，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，方可调整或变更本章程规定的现金分红政策。

## 二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况

### （一）公司最近三年现金分红情况

2020 年 4 月 17 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 191,802,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 9,590,146.55 元。公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕。

2019 年 4 月 18 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本

191,802,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 9,590,146.55 元。公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕。

2018 年 4 月 19 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 192,273,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 9,613,653.55 元。公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕。

最近三年，公司利润分配情况如下表：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
现金分红金额（含税）	959.01	959.01	961.36
归属于母公司所有者的净利润	5,612.07	4,233.25	3,842.98
占归属于母公司所有者的净利润的比率	17.09%	22.65%	25.01%
最近三年累计现金分红金额	2,879.38		
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	4,562.77		
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	63.11%		

## （二）公司近三年未分配利润使用情况

综合行业状况、公司发展战略、公司发展阶段以及业务特点等因素考虑，公司留存未分配利润将主要用于公司扩大生产经营和资本运作活动，一方面为公司业务发展、课题项目开展、延伸产业链和补充生产经营资金作储备和支撑，另一方面为进一步优化资本结构、提升股东价值和回报作相应准备。

## 三、公司股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》，主要内容如下：

### （一）公司股东回报规划制定考虑因素

公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

### （二）公司股利分配计划制定原则

公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。同时，充分听取公司独立董事和中小股东的意见，注重公司股本扩张与业绩增长保持协调。

### （三）公司股利分配计划制定周期

在审议制定或调整股东回报规划的议案时，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

### （四）公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报具体规划

1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。其中现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每

年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。公司经综合考虑具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项的决策程序和表决机制如下：

(1) 董事会的研究论证程序和决策机制

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。



公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

#### (2) 监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

#### (3) 股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。

#### (4) 利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。有重大投资计划或重大现金支出等事项发生除外。

公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部

监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。经过详细论证后，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，方可调整或变更本章程规定的现金分红政策。

#### 5、本规划的制定周期

在审议制定或调整股东回报规划的议案时，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

#### 6、解释及生效

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

## 第六节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了公司关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号）等法律法规，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

### 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

#### （一）主要假设

以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设本次向特定对象发行于 2020 年 12 月底完成，该时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经深交所核准并报中国证监会注册后的实际发行完成时间为准；

2、本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 55,000 万元（不考虑扣除发行费用的影响），发行股份数量上限为 7,480.31 万股。（该募集资金总额和发行数量仅为估计值，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）；

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

5、假设公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2019 年分别增长 0、10%、20%；

6、2019 年度公司的现金分红的金额为 959.01 万元，并于 2020 年 5 月实施；

7、在测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，即假设公司不会实施其他会对总股本发生影响或潜在影响的行为；

8、假设 2020 年期末归属于母公司所有者权益=2020 年期初归属于母公司所有者权益+2020 年度归属于母公司股东的净利润-2019 年度现金分红+本次向特定对象发行募集资金总额；

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

项目	2019 年度/ 2019 年末	2020 年度/2020 年末	
		本次发行前	本次发行后
期末股本（万股）	19,180.29	24,934.38	32,414.69
本次募集资金总额（万元）			55,000.00
本次发行股份数量（万股）			7,480.31
<b>假设一：2020 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2019 年度持平</b>			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,612.07	5,612.07	5,612.07
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后净利润（万元）	4,623.26	4,623.26	4,623.26
归属于上市公司股东的净资产（万元）	73,726.60	78,379.66	133,379.66
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	0.17

稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	0.17
基本每股收益（扣除非经常损益后）（元/股）	0.24	0.19	0.14
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）	0.24	0.19	0.14
加权平均净资产收益率	7.87%	7.39%	4.28%
加权平均净资产收益率（扣除非经常损益后）	6.48%	6.09%	3.53%
<b>假设情形二：2020 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2019 年度增长 10%</b>			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,612.07	6,173.28	6,173.28
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后净利润（万元）	4,623.26	5,085.59	5,085.59
归属于上市公司股东的净资产(万元)	73,726.60	78,940.87	133,940.87
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	0.19
基本每股收益（扣除非经常损益后）（元/股）	0.24	0.20	0.16
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）	0.24	0.20	0.16
加权平均净资产收益率	7.87%	8.10%	4.70%
加权平均净资产收益率（扣除非经常损益后）	6.48%	6.67%	3.87%
<b>假设情形三：2020 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2019 年度增长 20%</b>			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,612.07	6,734.49	6,734.49
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后净利润（万元）	4,623.26	5,547.91	5,547.91
归属于上市公司股东的净资产(万元)	73,726.60	79,502.08	134,502.08
基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	0.21
基本每股收益（扣除非经常损益后）（元/股）	0.24	0.22	0.17
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）	0.24	0.22	0.17
加权平均净资产收益率	7.87%	8.80%	5.12%

加权平均净资产收益率（扣除非经常损益后）	6.48%	7.25%	4.22%
----------------------	-------	-------	-------

注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》规定计算。

## 二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本增加，本次向特定对象发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次向特定对象发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。

同时，公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2020 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

## 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	半导体智能制造产业基地项目（一期）	40,228.98	40,000.00
2	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		<b>55,228.98</b>	<b>55,000.00</b>

本次向特定对象发行的必要性和合理性等相关说明详见本预案“第二节、董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。

## 四、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施

为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金合理使用，同时有效防范即期回报被摊薄的风险，具体的措施包括：

为有效防范本次向特定对象发行股票可能带来的即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，保证此次募集资金的有效使用，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：

### **1、推进募投项目建设，加快实现预期目标**

公司本次募集资金投资项目为半导体智能制造产业基地项目（一期）、补充流动资金项目，符合国家产业政策及公司未来战略规划方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，随着项目建成投产，公司整体经营业绩和盈利能力将逐步提升，有利于减少本次向特定对象发行对股东即期回报的摊薄。本次募集资金到位后，公司将充分调配资源，合理制定开工计划，加快推进募投项目的建设，使募投项目尽早达到达产状态，实现预期效益。

### **2、加强经营管理和内部控制，提升盈利能力**

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

### **3、加强募集资金管理，提高资金使用效率**

为规范募集资金使用管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、审批、监督管理等作出了明确规定。

本次募集资金到位后，公司将严格遵守《募集资金管理制度》，开设募集资金专项账户，按照约定用途合理使用募集资金，并积极配合保荐机构和监管银行对资金使用情况进行定期检查监督，确保公司规范、有效使用募集资金。

### **4、完善公司治理架构，强化内部控制管理**

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定要求，不断完善公司法人治理结构，确保股东以及董事会、独立董事、监事会能够充分有效行使相应权利和职责，为公司发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强

企业经营管理和内部控制，优化预算管理流程，降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

### **5、严格执行利润分配政策，优化投资回报机制**

为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》。本次向特定对象发行完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。

### **6、加强人才队伍建设，积蓄发展活力**

公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

综上，本次发行完成后，公司将聚焦主业，提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

## **五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

为充分保护本次向特定对象发行完成后公司及社会公众投资者的利益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人分别对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺，具体如下：

### **（一）董事、高级管理人员的承诺**

公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：



“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、未来公司如实施股权激励，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

## （二）控股股东、实际控制人的承诺

公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“针对本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”

## 六、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。（以下无正文）

（本页无正文，为《光力科技股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票预案》之盖章页）

光力科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月14日